



洗淨

のことなら
化研テック

フラックス洗淨
ペースト・樹脂洗淨
パーティクル洗淨
脱脂洗淨 など
実装工程の各種洗淨システムを
開発・製造しています。

インターネットコンジャパンに出展中！＜東1ホール E2-32＞

半導体

ダイシング加工のサントック

どうやって作成したの？

ウエハをうすくして0.5mm□に切ったんだよ

私のお腹は？

二次元バーコードになる様に移載したよ

HP二次元バーコード(チップ)

二次元バーコード作成動画

詳しくは▶

ネプコンジャパン 2025

会期 1/22金 - 1/24金

会場 東京ビッグサイト 東2ホール

E19-11

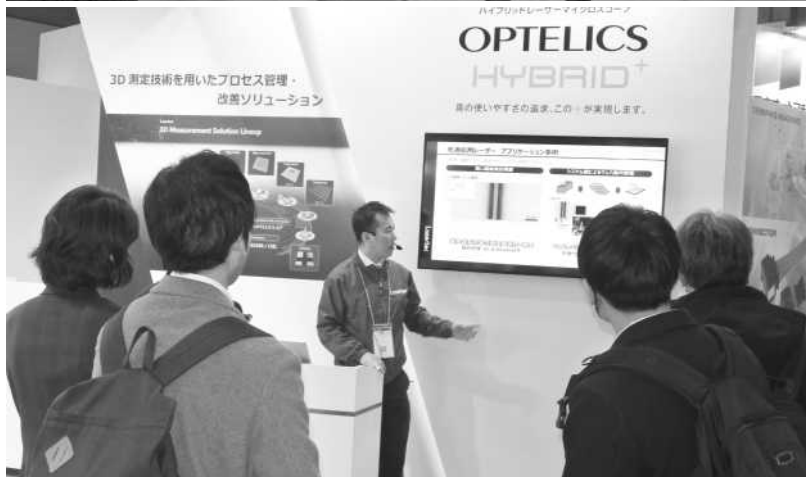
<https://www.c-suntec.co.jp/>

〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-1-10
TEL 042-557-7744(代) FAX 042-557-7745

削る・切る・詰る・観る
株式会社 サントック
ISO9001、14001 認証取得

エレクトロニクス-製造・実装・検査 最前線

ネプコン ジャパン 7 構成展



【上】奥野製薬工業はガラス基板向けスルーホールフィリング硫酸銅めっき添加剤を出品する（半導体・センサ パッケージング展）
【下】エレクトロテスト ジャパンではR&Dや量産ラインに対応した検査・試験装置や技術が紹介される（レーザーテック）

半導体・センサ パッケージング展

第20回「半導体・センサ パッケージング展」は、半導体パッケージングは採用するアプリケーションにより小型化、低消費電力、高信頼性、低コストなど、求められる要件が異なる。これらには2・x Dや3 D、再配線層（RDL）、シリン、設計・試作・製造・テストの受託サービスを集めた「設計・試作・製造受託ソリューション」が設けられている。

どうした中、展示会では半導体やセンサの製造、組み立て装置、パッケージング材料、めっき技術などパッケージング技術に特化。

表面処理技術にフォーカスした「めっき・エッチング・シリン、設計・試作・製造・テストの受託サービス」を集めた「設計・試作・製造受託ソリューション」が設けられている。

エレクトロテスト ジャパン

第39回「エレクトロテスト ジャパン」エレクトロニクス検査・試験・測定展はエレクトロニクスの研究開発（R&D）や製造分野で用いられる各種分析装置などの検査・試験装置が紹介される。半導体デバイスや微小電気機械システム（MEMS）といった微細形状の観察・測定を行う顕微鏡など、R&Dや量産ラインに向けて提案される。また「非破壊検査ゾーン」を設置している。

電子部品・材料 EXPO

第26回「電子部品・材料 EXPO」はエレクトロニクス製品の高機能化・軽薄短小化を支える実装回路や半導体デバイスの材料、コネクタやケーブルなどの電子部品に加工技術手法などが紹介される。

プリント配線板 EXPO

第26回「プリント配線板 EXPO（PWB）」はプリント配線板・材料、設計・開発受託、設計ツールなどを対象とした展示会。

微細加工 EXPO

第15回「微細加工 EXPO」はエレクトロニクス業界向けの板金や切削、プレス、電鍮、エッチング、表面処理、素材加工技術などの精密・微細加工技術を持つ企業から最新動向が提案され、各社の加工技術などが紹介される。

パワーデバイス & モジュール EXPO

第2回「パワーデバイス & モジュール EXPO」は、省エネルギー化に欠かせないパワーデバイスとパワーモジュールの専門展。関連する部品・材料、製造・検査装置が提案される。

インターネットコン ジャパン

日本スぺリア社

日本スぺリア社の鉛フリーハンダ「Temp Save」シリーズは、資材コスト低減とCO₂排出量の削減に貢献している。国内の大手家電メーカーの量産品に採用された「Temp Save B58」は、ヒスマス58%、スズ42%の合金で、フローハンダ付けが可能。特に銀の含有をゼロにしたことで、大幅なコスト低減を実現。融点130度Cで低温接合でき、実装工程の消費電力を約3割削減できる。

中国とマレーシアの新工場が2023年に稼働。現地ニーズと生産需要に対応。中国内では5拠点目となり、現地体制をさらに強化。マレーシアでは、二つ目の工場として研究開発（R&D）施設を併設している。

F U J I

FUJIIは新世代の実装機「NEXT R（ネクスリアル）Sモデル」「同Aモデル」そして「AIMEX R（エイメックスリアル）」を展開する。新機種により、最先端の実装ソリューションを披露する。

完全モジュラリティーをコンセプトにするNEXTシリーズのハイエンド機のSモデルと同Aモデルは、高度な生産性と効率性を追求した次世代の実装機。特にAモデルは高品質と生産性を維持する機能を強化し、段取り替えや部材補給作業を完全自動化した。

AIMEXシリーズのハイエンドモデルのRは、拡張型オールインワンタイプ。多品種少量・変種少量生産に対応するため、高度な汎用性と拡張性を持つ。

インターネットコン ジャパン

チノー

チノーは半導体製造プロセスに応じた放射温度計や温度センサー、サーモグラフィ、計装コントローラーを出品する。

デジタルビデオスコープ付き放射温度計「TRCZ」は、均一サイズの結晶インゴットの生産に必要な機能として、測定箇所を120万画素で撮影し映像化。温度値とトレンドグラフも同時表示できる。人工ダイヤモンドの種結晶の温度監視にも利用できる。

小形放射温度計「TR-BZN」は、各工程間の搬送温度を1秒の速度で温度監視できる。新製品の計装コントローラーは、フィードバックとシーケンスの制御を高度に融合することでウェハー成膜の多入力・多出力の高速制御に対応する。

出展企業の製品・技術 順不同



ハンダ材料は低温ハンダや車載向けなどが紹介される（日本スぺリア社）

インターネットコン ジャパン

エレクトロニクス製造・実装展

ブース番号：E64-8

先進、挑戦

ものづくりの課題に挑む。

高品質で持続可能なものづくりに貢献するために。
JCUは、世界に誇る表面処理技術と研究開発力で
加速する時代に挑み続けます。

株式会社 JCU

つなぐを
化学する

詳しくはこちら

ARAKAWA
CHEMICAL

荒川化学工業株式会社

第26回

半導体・センサ パッケージング展

半導体後工程の専門展 **ISP**

会期：2025.1.22(水)～24(金) 会場：東京ビッグサイト 東7ホール[E63-62]

出展のご案内

120th

無限の可能性

先端の半導体パッケージングを支える
オクノの表面処理薬品

半導体ウエハ用めっき薬品・めっき装置
ガラス基板向けめっき薬品
パッケージ基板向けめっき薬品
パワーデバイス向けめっきプロセス
プリント配線板向け最新表面処理

妄想をカタチに。 **TORYZA**

www.okuno.co.jp

TOP

奥野製薬工業株式会社

Measure with Passion
温度を極める

ネプコン ジャパン
エレクトロニクス開発・実装展

ブース番号 **E66-15**

高速計測を要する複雑なシステムに
新計装コントローラ
ForgaN

ー269℃までの極低温計測に
白金・コバルト
測温抵抗体

半導体製造に特化
放射温度計

安全・安心を支える計測・制御・監視(システム/機器/センサ)

CHINO
株式会社チーノ

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
TEL.03(3956)2111 FAX.03(3956)8927
https://www.chino.co.jp/

インターネット コン ジャパン

日本オートマチックマシン

日本オートマチックマシンは、新型の全自動高速端子圧着機をベースに開発した端末圧着・ハンダ処理機「CPR-F-ZERO-H」を初披露する。端子にハーネスを圧着・ハンダ付けできる。新たなハンダユニットを搭載したこと、スムーズな段取り替えを実現し、作業者の負担を軽減する。

同社ブースではハーネス加工の実演に加え、生産性向上と業務環境改善に貢献する新機能「移動データ監視システム」のデモを行う。このほか、ピン間隔が2.0mmピッチの自動車用小型高機能「NKコネクタ」「NKWコネクタ」、4.2mmピッチ電源用中継タイプ「RVコネクタ」などを中心とする電子部品を展示する。

ジャパンユニックス

ジャパンユニックスは上下両面からレーザー照射が可能なレーザーハンダ付けシステム「デュアルエリアレーザー」を提案する。同製品は特定エリアのハンダ付けを多点同時に行えるほか、通常のハンダ付け手法も可能とする。局所過熱により基板への熱負荷を軽減でき、サイクルタイム短縮や低消費電力を実現する。下方からのハンダ付けでは基板回転治具が不要のため、生産工程での省スペース化にも貢献する。

新自動ハンダ付けコントローラー「USC-06」は設備機器とデータ通信ができ、ハンダ付けの品質管理や工程の最適化に活用できる。また、ハンダ付けの自動化について、導入前から技術支援する体制も紹介する。

化研テック

化研テックは電子実装のフラックス残さや、ハンダパレットの洗浄で実績を持つ。展示会では新開発のパーティクル除去専用システム「マイクロクリナーFPS」を展示する。

マイクロクリナーFPSは、水を使わないシステム。また、高いパーティクル除去性と環境負荷の低減を両立している。専用洗浄剤「マイクロクリナーFPS」は皮脂など由来の有機異物に加え、微小異物に対しても高い除去性能をもつ一方、低VOC（揮発性有機化合物）、PFAS（有機フッ素化合物）フリーを実現。蒸留再生器で清浄度を維持し、1液で洗浄からリンスまでが可能。廃液レスと低ランニングコストを実現している。

荒川化学工業

荒川化学工業はロジックミストリー、機能性ポリマー設計をベースとしたコア技術と素材をもとに、電子部品・半導体デバイスなどエレクトロニクスに欠かせない多様な材料に新たな機能と付加価値を提供する。

今回は第5世代通信（5G）／6Gに貢献する材料「低誘電率リイミッド樹脂PIAD」や「低誘電粘着剤」を展示。微小電気機械システム（MEMS）の中空封止に向く「感光性ポリイミド」、ディスプレイの高輝度化と低消費電力化に寄与する「低・高屈折率レジスト材料」も紹介する。

また、水溶性フラックスや水溶性フラックス用洗浄剤など半導体製造の後工程で活躍する素材を展示する。

奥野製薬工業

奥野製薬工業はガラス基板向けスルーホールフライング硫酸銅めっき添加剤「トップルチナGCSシリーズ」を出品する。ガラス基板は寸法安定性に優れた一方、レーザーなどで穴開けされることから小径かつ高アスペクト比のスルーホールが形成される。この基板をボイドレスで高速に充填するめっき技術が求められている。

トップルチナGCSシリーズはPRパルス電解用添加剤の「同PR」と、直流電解用添加剤の「同TF」をそれぞれ用いためっき液を併用することにより、ボイドフリーで大幅な電解時間の短縮を実現した。

このほか、半導体ウエハ向け表面処理を中心に、ブースで最新技術を紹介する。

J C U

J C Uは配線形成に必要な銅めっき、エッチング薬品を中心にモティファイドセミアダプティブ工法（MSAP）、セミアダプティブ工法（SAP）に最適なプロセスを提案する。

また、半導体向け新ブランド「TIPHAREDS（ティファレス）」シリーズに関し、次世代半導体製造の後工程で用いられる再配線層向け硫酸銅めっき薬品のほか、チタン／銅／バター層一括エッチング薬品、銅レライ用高速硫酸銅めっきプロセス、前工程のシリコン貫通電極（TSV）用硫酸銅めっきプロセスの紹介も予定する。

さらに、Cu/Cu（銅と銅）間を直接接合する対応薬品などの新技術も提案する。

半導体・センサ パッケージング展

サンテックは国内外で400社以上の企業・大学・研究機関からシリコンウエハやガラス基板などのダイシング加工の受託を請けている。展示会では①炭化ケイ素（SiC）や異なる素材の貼り合わせなど素材を選択しない加工技術②ウエハのカッティングの中心点を自由に設定し、1枚のウエハから一度に複数枚のサークルカット加工が可能など③でもサークルカット③曲線加工を実現した自社マシンニング加工事例を紹介する。

また、少量多品種生産に最適な自社開発の「AI外観検査装置」を提案する。ダイシング加工前後のウエハの汚れや傷、欠けなどを、AIを使って外観の検査が行える。

レーザーテック

レーザーテックはコンフォーカル光学系を用いた検査・測定装置を展示する。半導体、微小電気機械システム（MEMS）、フィルムや各種材料の微細形状観察・測定を行う多機能コンフォーカル顕微鏡「OPTELICSHYBRID」に加え、高速自動検査・測定に特化した「OPTELICSAI2」と「PMシリーズ」を紹介。これら機種は、透明試料で裏面反射の影響を受けずに高倍率レベニュー、形状を測定する。

このほか、先端半導体の内部観察・測定を実現する「OPTELICSAI2」なども出品。R&Dから量産まで各フェーズに対応できるさまざまなソリューションを提供する。

J.A.M.

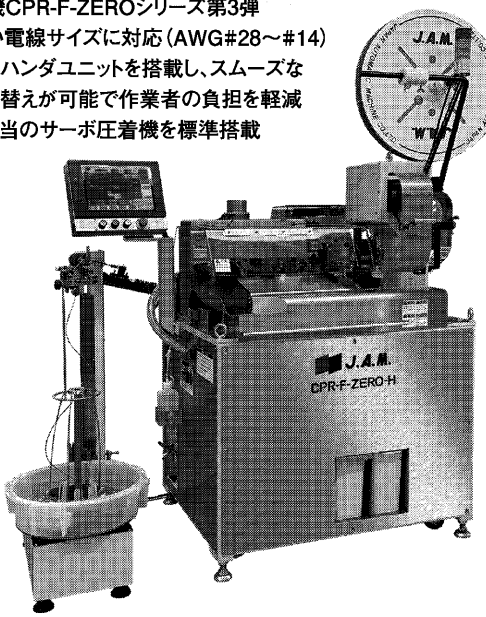
MACHINES & CONNECTORS

私たちは接続技術のプロフェッショナルです

高速全自動端子圧着機（片端圧着・片端ハンダ）

CPR-F-ZERO-H

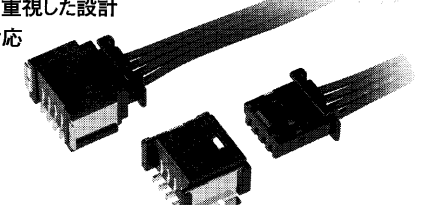
●高速機CPR-F-ZEROシリーズ第3弾
●幅広い電線サイズに対応（AWG#28～#14）
●新たなハンダユニットを搭載し、スムーズな段取り替えが可能で作業者の負担を軽減
●2.5t相当のサーボ圧着機を標準搭載



自動車用コネクタ

NKS・NKW

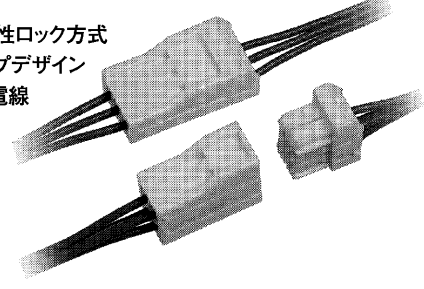
●耐振動性と耐衝撃性を重視した設計
●高温周辺温度（125℃）対応
●サイドリテーナにより、コネクタ不完全挿入を防止
●大型補強タブで基板剥離強度を大幅に増強



電源用中継コネクタ

RVA

●確実な結合を保証する慣性ロック方式
●指に優しいラウンドシェーブデザイン
●2種類のバルブで幅広い電線サイズに対応
●安定した挿入感を保つハウジングロックガードを採用



日本オートマチックマシン株式会社

https://www.jam-net.co.jp/

本社 〒146-0092 東京都大田区下丸子 3-28-4 TEL(03)3756-1431
国内営業拠点 東京・横浜・大阪・名古屋・福岡・福島（南相馬）・埼玉（熊谷）
海外営業拠点 中国（惠州・深圳・蘇州・上海）香港・シンガポール・タイ・USA・スイス・マレーシア
生産拠点 横浜・福島（南相馬・いわき）・中国（惠州）・タイ・インド

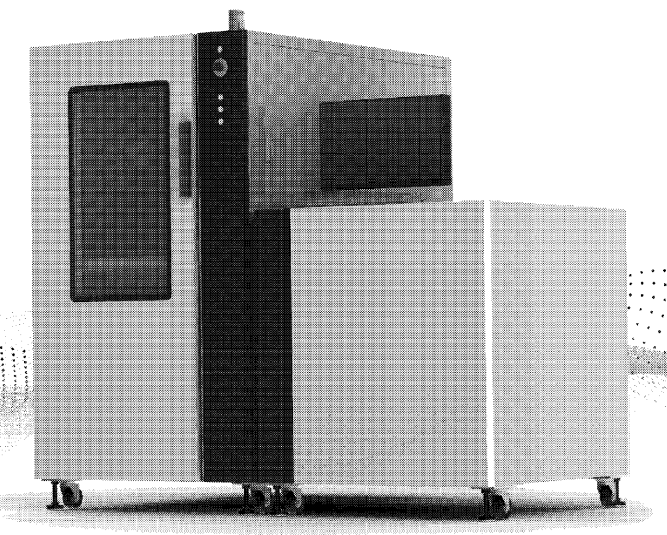
2つの工法をシームレスに実現！
エリア・シングルレーザーを1台で！

デュアルレーザーソルダーリングシステム

上からエリア、
下からシングルレーザーはんだ付

エリアタイプ（正方形）

シングルスポット



IPCセミナー情報

はんだ付の国際認証資格
CISTレーニング



IPC-7711/21
CIS新規セミナー
2025年3月11日(火)～14日(金)
2025年4月以降も順次開催！

場所：東京会場(御ジャパニクス本社)
お問い合わせ：tel.03-3588-0551 (IPC担当)

IPC標準規格

世界の製造業が採用 品質標準のグローバルスタンダード

電子組立品の許容基準
[IPC-A-610JP]

プリント板の受け入れ
[IPC-A-600JP]

お問い合わせ：tel.03-3588-0551 (IPC担当)
オンライントレーニング：https://training.ipcstore.jp

「相談から量産まで」支援するはんだ付のプロフェッショナル

JAPAN UNIX 株式会社 ジャパンユニックス <http://www.japanunix.com>

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-21-25 Tel. 03-3588-0551 Fax. 03-3588-0554
大阪営業所 Tel. 06-6190-4580 Fax. 06-6190-4581 名古屋営業所 Tel. 052-679-2111 Fax. 052-679-2112 熊本テクノセンター Tel. 096-287-4501 Fax. 096-287-4503

評価・検証等
技術的な問合せ
受付中！

第39回

インターネット コン ジャパン

エレクトロニクス製造・実装技術展

会 期：2025年1月22日(水)～24日(金)

会 場：東京ビッグサイト 東1ホール 小間番号：E7-42